

各位

上場会社名 アピックヤマダ株式会社
代表者 代表取締役社長 押森広仁
(コード番号 6300)
問合せ先責任者 取締役企画部長 小出 篤
(TEL 026-275-2111)

業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成27年5月14日に公表した平成28年3月期(平成27年4月1日～平成28年3月31日)の第2四半期累計期間業績予想を下記の通り修正いたしますのでお知らせいたします。

記

● 業績予想の修正について

平成28年3月期第2四半期(累計)連結業績予想数値の修正(平成27年4月1日～平成27年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する四半期純利益	1株当たり四半期純利益
前回発表予想(A)	百万円 5,400	百万円 △150	百万円 △140	百万円 △150	円 銭 △12.07
今回修正予想(B)	4,100	△430	△410	△400	△32.20
増減額(B-A)	△1,300	△280	△270	△250	
増減率(%)	△24.1	—	—	—	
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成27年3月期第2四半期)	5,491	123	127	136	10.98

平成28年3月期第2四半期(累計)個別業績予想数値の修正(平成27年4月1日～平成27年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり四半期純利益
前回発表予想(A)	百万円 4,700	百万円 △105	百万円 △100	百万円 △110	円 銭 △8.85
今回修正予想(B)	4,000	△350	△300	△300	△24.15
増減額(B-A)	△700	△245	△200	△190	
増減率(%)	△14.9	—	—	—	
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成27年3月期第2四半期)	4,874	92	246	252	20.35

修正の理由

第2四半期連結累計期間につきましては、半導体部品組立製造装置において、受注が計画を上回り推移しましたが、新規開発装置が多く想定より納期が延びた案件が発生しており、第2四半期累計期間の売上が計画を下回ること、また電子部品においてはLEDプリモールド基板事業で生産機種の入替えに伴う受注の減少が想定より長引いていること、以上を主な要因として売上、収益両面において計画を下回る見込みとなりました。このような状況を踏まえ、第2四半期累計期間の連結及び個別の業績予想を上記のとおり修正いたします。

なお、通期業績予想につきましては、現状では受注が計画を上回って推移していることから、平成27年5月14日公表の通期業績予想は修正いたしません。今後の市況や業績動向等を踏まえ、修正が必要と判断した場合は速やかに開示いたします。

(注)上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

以上